

证券代码： 300219

证券简称：鸿利智汇

鸿利智汇集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-004

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资者关系活动类别     | <div><div><input checked="" type="checkbox"/>特定对象调研</div><div><input type="checkbox"/>分析师会议</div><div><input type="checkbox"/>媒体采访</div><div><input type="checkbox"/>业绩说明会</div><div><input type="checkbox"/>新闻发布会</div><div><input type="checkbox"/>路演活动</div><div><input type="checkbox"/>现场参观</div><div><input type="checkbox"/>一对一沟通</div><div><input type="checkbox"/>其他（请文字说明其他活动内容）</div></div> |
| 参与单位名称及人员姓名   | 平安基金刘文平                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 时间            | 2026 年 10 月 13 日（星期二）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 地点            | 公司会议室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 上市公司接待人员      | 副总裁、董事会秘书、财务总监：赵军<br>证券事务代表：刘冬丽                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <div>一、介绍公司基本情况</div> <p>公司成立于 2004 年，于 2011 年 5 月在深交所创业板上市，是国内领先的集研产销于一体的 LED 半导体封装器件产品上市企业。主营业务包括 LED 半导体封装、汽车照明及电子、Mini/Micro LED 显示。公司在广州、深圳、东莞、南昌、镇江、美国、泰国拥有生产基地，产品远销全球 70 多个国家和地区。2020 年荣获国家科学技术进步奖一等奖，是全球优质主流照明供应商。在 2025 年全球照明 LED 封装厂商营收排名第二。</p> <div>二、互动问答</div> <p><b>问：LED 照明行业发展现状。</b></p> <p>当前国内 LED 照明行业呈现整体承压、结构性复苏的发展格局。受全球地缘政治格局变化、海外需求波动及国内房地产行业下行等多</p>                        |

重外部因素叠加影响，传统通用照明板块需求走弱，对应市场规模有所收缩，但汽车照明、植物照明、UV LED、医疗美容照明等细分领域表现突出，展现出广阔的市场前景。

**问：LED 照明产品竞争优势。**

公司通过积极优化客户、产品结构，提升盈利能力。公司聚焦大功率器件、户外照明、车规级支架等战略品类，通过定制化研发提升竞争力，战略品类收入实现稳步增长。未来，公司将持续保持高度敏锐的市场洞察力，紧密跟踪市场动态变化，依据市场态势灵活、精准地调整市场策略，以应对可能出现的各种挑战和机遇。

**问：公司 Mini LED 产品核心原材料构成。**

公司 Mini LED 封装产品核心原材料包括芯片、PCB、IC 组件等。

**问：公司主要销售模式。**

公司产品销售以直销模式为主。

**问：公司目前在手订单及生产情况。**

根据市场情况及行业周期变化，公司在手订单呈现稳定态势，生产经营有序开展，产能按计划排产，订单交付工作正常推进。

**问：今年上半年业绩增长的原因。**

今年上半年业绩增长，主要是公司坚持差异化竞争路线，聚焦高附加值细分赛道，持续迭代产品技术、优化产品矩阵与客户结构，同时强化成本管控、实现降本增效。

**问：公司 Mini LED 经营情况。**

公司 Mini LED 以倒装芯片 COB 技术路线为核心，技术相对成熟，是公司主要工艺路线，目前生产的 Mini LED 产品以直显为主，今年 Mini LED 业务订单较去年同期有所增长。

**问：设立泰国公司的目的及进度情况。**

投资设立泰国公司，能够有助于公司实现全球化战略布局，提升海外运营能力，进一步增强在全球市场的整体竞争力，推动公司业务的国际化发展。同时也为了满足国际客户的海外配套需求，致力于提供更具竞争力的产品与服务体系，深化头部客户合作关系。目前泰国

|                      |                                                                                                                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <p>公司已于 2026 年 4 月设立，现正处于厂房装修阶段。</p> <p><b>问：公司拓展新的业务的想法。</b></p> <p>公司围绕“一体两翼”产业发展战略，在立足现有产业基础上，辐射先进封装、泛半导体、精密制造、人工智能等前沿技术领域开展战略布局，稳步培育新业务增长点。</p> <p><b>三、参观展厅、车间</b></p> |
| 关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明 | 本次活动不涉及未公开披露的重大信息。                                                                                                                                                          |
| 附件清单                 | 无                                                                                                                                                                           |
| 日期                   | 2026 年 10 月 13 日                                                                                                                                                            |